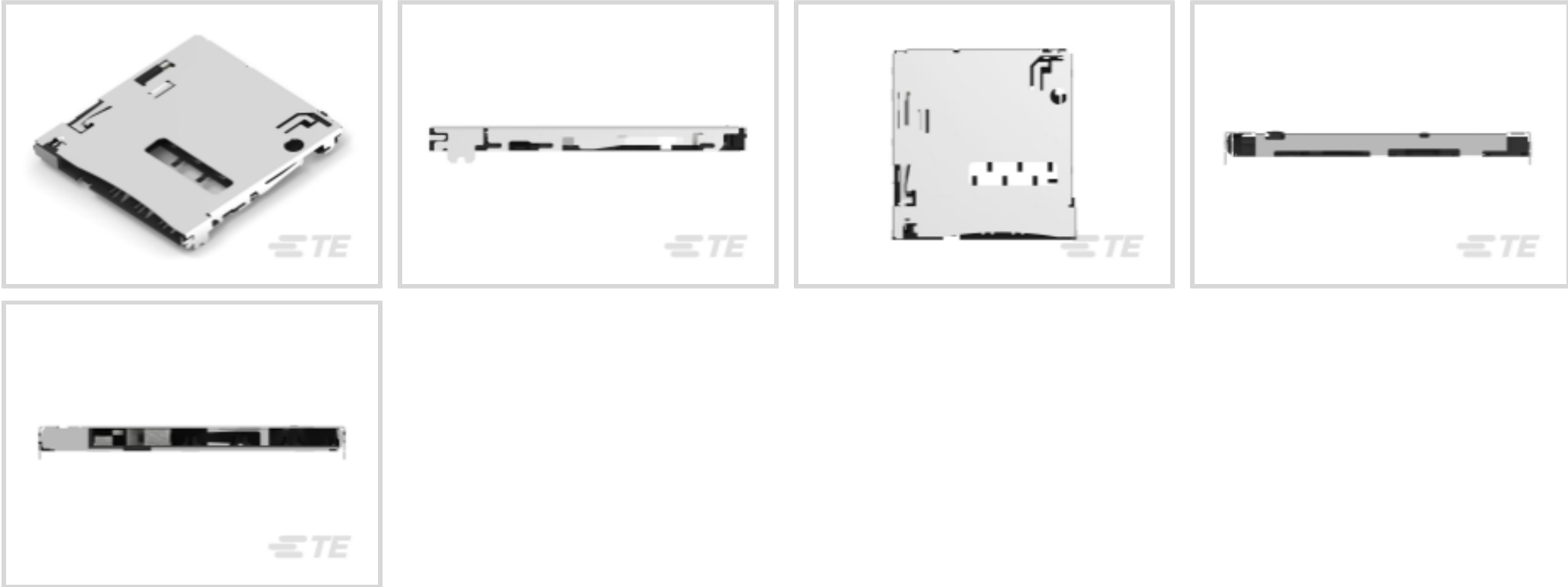




TE 内部编号 2822541-1
SIM Card Connectors, SIM/SAM Compatible Card, Board-to-Board,
6 Position, 2.54mm [.1in] Centerline, 6 Loaded Position, Surface
Mount
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 内存卡连接器 > SIM 卡连接器



兼容卡: SIM/SAM
连接器系统: 板对板
Number of Positions: 6
中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]
装载位置数量: 6

产品特性

产品类型特性

兼容卡	SIM/SAM
连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	6
装载位置数量	6

接触件特性

端子额定电流（最大值）	.5 A
-------------	------

机械附件

PCB 安装方式	表面贴装
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

使用环境



工作温度范围	-30 – 85 °C[-22 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

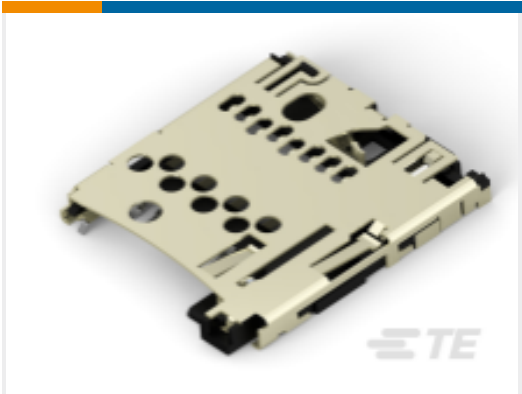
如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

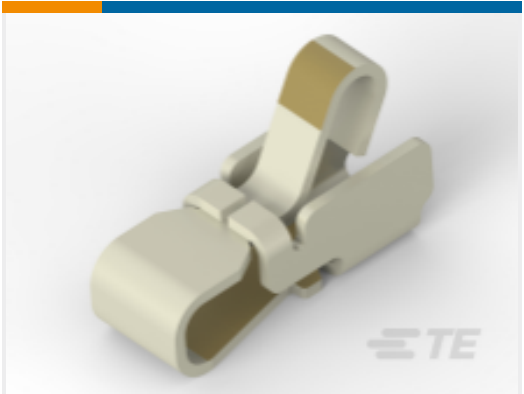
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2201778-1
MICRO SD PUSH PUSH LOW PROFILE TYPE



TE 产品编号 1554901-1
SHIELD FINGER 2011 EMBOSS TYPE



TE 产品编号 2336582-1
PUSH-PUSH NANO SIM CONNECTOR

客户还购买了



 TE 产品编号1-1827862-5 Dynamic 1100 母端和公端壳体	 TE 产品编号1-1827876-3 DYNAMIC 1200D HDR ASSY H 6P XBLACK GOLD	 TE 产品编号86557-6 FFC PIN ROUND WIRE PLATED	 TE 产品编号1734753-1 MINI USB, TYPE B, VERTICAL, T/H
 TE 产品编号1734035-4 MINI USB, TYPE B, R/A, SMT, MYLAR	 TE 产品编号1-2295018-2 USB TYPE C, REC OFFSET 0.65MM DUAL SMT	 TE 产品编号1-2301994-2 RJ45 JACK INT.MAG. 1GB LED 1X1	 TE 产品编号1-2176328-9 CRGP 1206 330R 1%

文档

产品图纸

PUSH-PUSH MICRO SIM CONNECTOR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2822541-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2822541-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2822541-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

产品规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本